

# 國立交通大學

工學院半導體材料與製程設備學程

## 碩士論文

### 錫鉛覆晶鐸錫中金屬墊層電遷移與熱遷 移行為之研究

Effect of UBM structure on Electromigration and  
thermomigration behavior in flip chip SnPb solder joints

研究生：李侑錚

指導教授：陳智博士

游欽宏博士

中華民國一百年七月

錫鉛覆晶銲錫中金屬墊層電遷移與熱遷移行為之研究  
Effect of UBM structure on Electromigration and  
thermomigration behavior in flip chip SnPb solder joints

研 究 生：李侑錚                      Student：Yu-Cheng Lee  
指 導 教 授：陳 智 博 士          Advisor：Dr. Chih Chen  
                 游欽宏 博 士          Advisor：Dr. Chin-Horng Yau

國 立 交 通 大 學

工 學 院 半 導 體 材 料 與 製 程 設 備 學 程  
碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Degree Program of Semiconductor Material and Process Equipment  
College of Engineering  
National Chiao Tung University  
in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of  
Master  
in

Program of Semiconductor Material and Processing Equipment

July 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百年七月